



2025학년도 반도체 신사유람단 글로벌 AI반도체 프로젝트 학생모집 공고

1. 목적

- 가. 글로벌 프로젝트를 경험하며 반도체 기술과 산업 흐름을 이해하고, 전공 연계 진로 계획 수립 역량을 강화
- 나. 혁신 기술 사례를 체험하며, 글로벌 기업 전문가와 교류를 통해 국제적 시야와 네트워크를 확대

2. 개요

- 가. 사업명: [2025학년도 반도체 신사유람단] 글로벌 AI반도체 프로젝트
- 나. 프로그램 운영기간: 2026. 1. 5.(월) ~ 1. 11.(일), 4박 7일 (* 일정은 변경될 수 있음)
- 다. 참여대상: 반도체특성화대학사업단 「반도체융합전공」 참여학생 12명
- 라. 운영장소: 미국 라스베이거스 및 캘리포니아 주요 반도체 산업 거점 지역
(1안: 실리콘밸리/산호세, 2안: LA/Irvine)
- 마. 운영내용: 국제전자제품박람회(CES 2026) 참관과 현지 기업·대학 탐방을 통해 반도체 기술 동향 분석 및 글로벌 역량 강화 프로젝트 수행

3. 주요내용

- 가. 글로벌 AI반도체 박람회 연계 프로젝트 운영
 - 1) 박람회명: 국제전자제품박람회(Consumer Electronics Show 2026)
 - 2) 행사기간: 2026. 1. 6.(화) ~ 1. 9.(금)
 - 3) 행사장소: Las Vegas Convention Center, Venetian Expo, Eureka Park
 - 4) 전시 공간별 주요 기술 영역
 - 가) LVCC (Las Vegas Convention Center)
 - (1) Central Hall: 대형 가전, XR/VR/메타버스, 디스플레이 및 오디오·비디오 기술
 - (2) North Hall: 스마트 커뮤니티, IoT, 지속가능 에너지, AI 기반 서비스
 - (3) West Hall: 모빌리티, 전기차, 자율주행, 배터리/파워 관리 기술
 - (4) South Hall: 디자인·소싱 제품, 친환경 소비자용 액세서리
 - 나) Venetian Expo

(1) C Space: 미디어·콘텐츠, 광고·브랜드 마케팅, 엔터테인먼트 테크

(2) 일반 전시홀: 스마트홈, 디지털 헬스·웰니스, 라이프스타일 가전, UX/UI 중심 제품

다) Eureka Park

(1) 혁신 스타트업 제품 전시: AI·엣지 컴퓨팅, 신소재, 로봇틱스, 헬스테크, 프로토타입 기술

5) 주요 프로그램 및 학술 트랙

가) 기조연설(Keynotes): 글로벌 기술 동향, 전략, 신제품 발표

나) 테크 컨퍼런스(Tech Talks): 산업별 최신 기술 심화 강연

다) 포럼 및 네트워킹 세션: 투자자 미팅, 산학협력 사례 공유, 글로벌 기업 및 스타트업 교류

6) 전공 연계 활용 포인트

(1) AI반도체, 엣지 컴퓨팅 등 전공 핵심 기술을 직접 관찰하며 학문적 이해를 심화함

(2) 글로벌 기업·스타트업의 산업 적용 사례를 분석하여 전공 지식의 실무적 확장 가능성을 탐색함.

(3) 현장 경험을 기반으로 전공 관련 연구 주제 발굴과 진로 탐색에 활용함.

7) 상세내용: CES 2026 홈페이지 참고(<https://www.ces.tech>)

나. 글로벌 AI반도체 기업 및 대학 연계 프로젝트 운영

1) 현지 대학(예정): Caltech, Stanford 등 주요 대학 중 1곳 방문하여 연구 시설 투어 및 유학생과의 네트워킹

2) 기업: 글로벌 AI반도체 관련 기업 방문, 기술 교류, 실무자 간담회 및 네트워킹

3) 목적: 주요 반도체 기업 및 연구 시설 탐방을 통해 AI반도체 관련 최신 기술 동향 파악 및 산업 적용 사례 학습

다. 프로그램 세부 일정(안)

일자	장소	일정 (1안)	일정 (2안)
26.1.5.(월)	출발	- 전북대학교 출발 → 인천공항 → LA	
	LA(경유)	- LA → 라스베이거스	
26.1.6.(화)	라스베이거스	- CES 참관 (LVCC: Central Hall, North Hall)	
26.1.7.(수)	라스베이거스	- CES 참관 (Venetian Expo: C Space · 일반홀 / Eureka Park)	
26.1.8.(목)	라스베이거스	- CES 참관 (LVCC: West Hall, South Hall)	
		- 라스베이거스→LA 이동	- 라스베이거스→샌프란시스코 이동
26.1.9.(금)	LA/ 샌프란시스코	- LA/Irvine 지역 반도체 기업 · 대학 탐방 및 네트워킹 - LA → 인천공항	- 실리콘밸리/산호세 지역 반도체 기업 · 대학 탐방 및 네트워킹 - 샌프란시스코 → 인천공항
26.1.10.(토)	이동	- 날짜 변경선 통과	
26.1.11.(일)	도착	- 인천공항 → 전북대학교 도착	

※ 세부 일정은 변경될 수 있음



4. 선발내용

가. 선발인원: 12명(4팀, 1팀 3명 구성)

나. 신청대상: 2025학년도 전북대학교 반도체특성화대학사업단 「반도체융합전공」 참여학생

※ 공고일 기준 학사학위취득유예자 및 졸업예정자 제외

다. 선발절차

1) 서류심사: 활동계획서 등 참가신청 서류 평가

2) 면접심사: PT 발표 및 면접 평가(10분 이내, 팀 구성원 전원 참석)

3) 심사기준(안)

구분	평가항목	배점	점수	비고
서류심사	1) 지원동기의 적절성	10점	30점	※ 서류심사 점수가 동점일 경우 팀 구성원 전체 성적의 평점평균 점수가 우수한 팀을 선발
	2) 활동 후 학업역량 발전 가능성	10점		
	3) 사업단 마일리지 취득 점수	10점		
면접심사	1) 활동 주제 및 지원동기의 적절성	20점	70점	※ 팀 구성원 전원이 발표해야 하며, 발표 태도에 따라 선발 여부 최종 결정
	2) 사전 조사 내용의 적절성	10점		
	3) 활동 내용의 적절성	10점		
	4) 팀 구성원의 도전정신 및 적극성	10점		
	5) 프로그램 이해 및 발표 태도	20점		
합계			100점	

라. 신청방법

1) 팀 구성: 1팀당 3명으로 구성

※ 선발 후 팀원 변경은 불허하며, 변경 인원이 있는 경우는 선발 취소 후 심사결과를 토대로 차순위 팀을 선발

2) 제출서류

구분	제출서류	비고
신청 시	[서식 1] 참가신청서	
	[서식 2] 활동계획서	
	[서식 3] 개인정보 수집·활용 동의서	
	재학증명서	2025. 9. 1. 이후 발급분만 인정
	성적증명서	
최종 선발 후	서약서	추후 안내 및 서식 제공 예정
	보호자 동의서	
	여권사본(선발 후 즉시 필요)	
프로그램 활동 이후	활동보고서 및 참여수기, 사진 등	





마. 추진 일정

구분	기간	내용
모집공고 및 홍보	2025. 10. 2.(목) ~ 10. 12.(일)	- 사업단 홈페이지 및 참여학생 단톡방 공지
참가신청 서류 접수	2025. 10. 2.(목) ~ 10. 12.(일)	- 담당자 E-mail(sgh4315@jbnu.ac.kr) 제출
서류심사	2025. 10. 13.(월) ~ 10. 14.(화)	- 선발내용 및 심사기준에 따라 서류 평가
서류심사 합격자 발표	2025. 10. 16.(목)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
발표자료 제출	2025. 10. 17.(금) ~ 10. 26.(일)	- 담당자 E-mail(sgh4315@jbnu.ac.kr) 제출
면접심사	2025. 10. 28.(화)	- PT 발표 및 면접
최종 합격자 발표	2025. 10. 30.(목)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
오리엔테이션	2025. 11월~12월 중	- 주요사항 안내 및 안전교육 진행
프로그램 활동 참여	2026. 1. 5.(월) ~ 1. 11.(일)	- 국제전자제품박람회(CES 2026) 참관과 현지 기업·대학 탐방을 통해 반도체 기술 동향 분석 및 글로벌 역량 강화 프로젝트 수행
결과보고	프로그램 참여 후 1주일 이내	- 활동보고서 및 참여수기 제출

※ 위 일정은 사업단 운영 상황에 따라 변동 가능

바. 지원자 유의사항

- 1) 참가자는 관련 서류를 누락 없이 반드시 제출해야 함
- 2) 프로그램 참여 후 사업단 요청 시 활동 및 성과 발표 등 행사 참여
- 3) 다음 사항 중 하나라도 해당 시 프로그램 참가 자격 박탈 및 위약금 부과

- 휴학, 자퇴, 취업 등 재학생 신분을 포기하였을 경우
- 개인적인 사정으로 프로그램 참가를 포기하였을 경우
- 신청 서류의 내용이 사실과 다른 경우
- 프로그램 진행 과정 전체에 불성실하게 임할 경우
- 제출서류를 기한 내 제출하지 않을 경우
- 프로그램 중 무허가 개인 활동으로 인해 문제가 발생한 경우

- 4) 지원자는 공고 및 유의사항 내용에 대한 미숙지로 인해 불이익이 발생하지 않도록 반드시 확인한 후 지원 결정

5. 지원사항

가. 지원내용: 전시회 등록비, 항공료, 숙박비, 식비, 체류 중 국가 내 이동 및 교통비, 비자 발급 비용, 입장료, 여행자보험 등 프로그램 관련한 비용 전액 지원

나. 지원불가: 여권 발급 비용, 개인 비용(용돈, 선물 등)

